

Laserpower für HF-Anwendungen auf der European Microwave Week in Madrid

Ansprechpartner:

Cordula Krause-Widjaja
cordula.krause-
widjaja@lpkf.com
Tel. +49 (0)5131 7095-1327
Fax +49 (0)5131 7095-90

**LPKF
Laser & Electronics AG**
Osteriede 7
D-30827 Garbsen
www.lpkf.de

Vorstand

Dr. Götz M. Bendele (CEO)
Kai Bentz (CFO)
Bernd Lange (CTO)
Dr. Christian Bieniek (COO)

Aktie:

Prime Standard
ISIN 0006450000

Abdruck frei, Beleg erbeten

» **Weitere Pressemeldungen**

Ein Verfahren zum extrem schnellen und dabei hochpräzisen Schneiden und Strukturieren von laminierten HF-Materialien und technischer Keramik stellt die LPKF Laser & Electronics AG auf der diesjährigen European Microwave Week vor. Sowohl auf dem Messtand 322 als auch bei einem Vortrag des Laserspezialisten Lars Führmann am 26.09. um 13.30 Uhr im MicroApps Theatre zeigt LPKF Möglichkeiten auf, HF-Anwendungen mit dem LPKF ProtoLaser U4 schnell und präzise zu realisieren.

Inhouse-Fertigung schafft Ingenieuren viel Gestaltungsspielraum für die Entwicklung und Fertigung von HF-Anwendungen. Der LPKF ProtoLaser U4 zur Mikromaterialbearbeitung arbeitet mit einem UV-Laser und wurde speziell für den Einsatz im Elektroniklabor entwickelt. Machbarkeitsstudien von Design-Projekten in einem sehr frühen Entwicklungsstadium oder Beurteilungen spezifischer Materialien für HF-Anwendungen lassen sich damit ohne zusätzlichen, dienstleisterbedingten Zeitaufwand durchführen.

Für laminierte Materialien, HF-Komponenten, FR4 oder dünne flexible Materialien wendet das Laser-System eine "Rubout"-Strategie an. Dabei wird das Kupfer durch thermische Effekte und Druckluftstrom entfernt. Mit der integrierten Software lassen sich auch Laserbohrungen und Konturschnitte generieren.

Auf technischer (gebrannter) Keramik wie Al₂O₃ oder GaN verdampft der Laser das Metall. Darüber hinaus kann der Anwender mit dem System Keramik schneiden oder auch Sacklöcher herstellen. Die Produkte überzeugen durch eine hohe geometrische Präzision, die sich im Bereich von +/- 2 µm (+/- 0,8mil) bewegt, sowie durch eine exakte Schnittkante.

Die einfach einzurichtende und anzuwendende Systemsoftware arbeitet mit Standard-Layout-Daten wie Gerber oder DXF. Sie generiert materialspezifisch optimierte Strategien, mit denen die Substrate so schonend wie möglich behandelt werden.

Ein besonderer Vorteil für kleinere, nicht-spezialisierte Labore: Die Technologie kommt chemiefrei zum Einsatz.



Abb. 1: LPKF ProtoLaser U4



Abb. 2: Lars Führmann, Department Manager Product Management, präsentiert den LPKF ProtoLaser U4

Über LPKF

LPKF Laser & Electronics AG produziert Maschinen und Lasersysteme, die in der Elektronikfertigung, der Medizintechnik, der Automobilindustrie und bei der Herstellung von Solarzellen zum Einsatz kommen. Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt.